



2010年8月18日

インテルとマイクロン業界初25nmプロセス技術採用 3ビット/セル NAND型フラッシュメモリのサンプル出荷開始

～ 業界最大容量、最小のNAND型フラッシュメモリ

消費者向け多数のストレージ・アプリケーションにコスト優位性を提供 ～

インテル コーポレーション(本社:米国カリフォルニア州サンタクララ)とマイクロン テクノロジー社(本社:米国アイダホ州ボイジー)は、業界で最大容量、最小のNAND製品となる、25nm(ナノメートル)プロセス技術を採用した3ビット/セル NAND型フラッシュメモリの出荷を発表しました。両社は、一部の顧客を対象に製品のサンプル出荷を開始しました。インテルとマイクロンは2010年内の量産出荷を予定しています。

25nmプロセス技術を採用した新しい64Gb(ギガ・ビット)の3ビット/セル NAND型フラッシュメモリは、競争の激しいUSB、SDカード、デジタル家電市場において、より優れたコスト効率と大容量化を実現します。フラッシュメモリは主にデータ、写真、その他のマルチメディアを記憶し、デジタルカメラ、ポータブル・メディア・プレーヤー、デジタル・ビデオカメラ、そしてパソコンを含むあらゆるデジタル機器間で、データ保存やデータ転送を可能にします。これらの市場では、低価格で大容量のストレージが常に求められています。

両社のNANDフラッシュメモリ合併会社であるIMフラッシュ・テクノロジーズ(IMFT)によって設計された64Gb(8GBバイトと同等)製品向け25nmプロセス技術による露光技術は、従来の1メモリ・セル当り1ビット(シングルレベル・セル)や2ビット(マルチレベル・セル)の情報ではなく、3ビットの情報を記憶する“トリプルレベル・セル”(TLC)を実現しています。

この新製品は、現在市場で最小の25nmプロセス技術を採用したインテルとマイクロンのシングルチップ8GB多値セル(MLC)製品と同じメモリ容量を集積しながら、20%以上の小型化を実現しています。フラッシュメモリの小型化は、特に消費者向け製品に不可欠なコンパクト設計が求められるフラッシュカードでは重要です。ダイ・サイズは131平方ミリメートルで、業界標準のTSOP(薄型スモール・アウトライン・パッケージ)で提供されます。

インテル コーポレーション 副社長 兼 NANDソリューション事業部長のトム・ランポーンは「1月に25nmプロセス技術による業界最小のダイサイズを発表しました。そして今回、25nmプロセス技術に基づく3ビット/セルへの移行を始めることで、我々は勢いを増し、業界をリードする魅力的な製品群を提供することができます。インテルは、新しい25nmプロセス技術による8GB TLC NANDデバイスを基本とした、高集積でコスト効率に優れた製品を顧客に提供するため、IMFTの設計および製造におけるリーダーシップを活用する計画です」と述べています。

マイクロン テクノロジー社 NANDソリューション事業担当副社長のブライアン・シャーリーは「一般消

費者向け家電製品におけるNANDメモリの役割が拡大するなか、我々は25nmプロセス技術による3ビット／セルへ早期の移行を行い、成長するNANDメモリ製品の競争力を高めます。我々は、8GB TLC NAND型フラッシュメモリを、レクサー・メディアおよびマイクロンの大容量ストレージ製品を含めた、最終製品への評価認定作業を既に始めています」と述べています。

関連リンク

以下のサイトでもインテルおよびマイクロン テクノロジー社の最新ニュースをご覧いただくことができます。

- Micron Innovations Blog: www.micronblogs.com
- Micron on Twitter: <http://twitter.com/microntechnews>
- Intel NAND Flash: www.intel.com/design/flash/nand
- Intel Blog: www.blogs.intel.com
- Intel on Twitter: <http://twitter.com/intelnews>
- Intel Communities: <http://communities.intel.com>

インテルについて

インテルは、革新的なコンピューティング技術で世界をリードする企業です。インテルは、仕事や生活で利用される様々なコンピューティング機器の基礎となる重要な技術を開発しています。インテルに関する情報は、<http://www.intel.co.jp>で入手できます。

マイクロン テクノロジー社について

マイクロン テクノロジー社は、先進的な半導体ソリューションを提供する世界的大手企業です。マイクロンは、世界全域での事業活動を通じ、最先端のコンピューター、家電製品、ネットワーキング、組み込み製品、モバイル機器などに使用される、DRAM、NANDおよびNORフラッシュメモリ全般、およびその他の革新的メモリ技術、パッケージングソリューション、半導体システムなどを製造・販売しています。マイクロン テクノロジー社の普通株式はNASDAQにMUのコード名で上場取引されています。マイクロン テクノロジー社に関する情報は、<http://www.micron.com> をご覧下さい。

- * ©2010 Micron Technology, Inc. and Intel Corporation. All rights reserved.記載された情報は予告なしに変更されることがあります。
- * マイクロンおよびマイクロンのロゴは、マイクロン テクノロジー社の商標です。
- * Intel、インテル、Intelロゴは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- * その他の社名、製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。

このプレスリリースは、3bpc 64Gb NAND デバイスの生産に関する将来予測を含んでいます。実際の事象や結果は、将来予測の記述に含まれる内容とは異なる可能性があります。マイクロン社が、随時、米証券取引委員会に提出する連結ベースの書類、具体的には、マイクロン社最新の「10-K」と「10-Q」を参照ください。これらの書類は、マイクロンによる連結ベースの実際の結果と「将来予測」に記載され

たものが大きく異なる原因となり得る重要な要因を含むとともに、それらを特定しています(「特定の要因」を参照)。「将来予測」に示された期待は妥当だと考えられますが、当社は将来の結果、活動のレベル、実績、業績などを保証するものではありません。

この件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

インテル株式会社

広報室 荒木

Tel: (03) 5223-9100(代表)

マイクロン ジャパン株式会社

才宮 章子

Tel: (0795)23-6609

E-mail: saimiya@micron.com